

「2025 차세대 반도체 패키징 산업전」 공동관 참가기업 모집공고

▣ 첨단 반도체 패키징 산업 동향을 파악하고, 참가기업의 네트워크 활동 기반 조성 등 반도체 패키징 기업 육성을 위한 「2025 차세대 반도체 패키징 산업전」 공동관을 운영하고자 합니다. 공동관에 함께 참여하고 싶은 기업은 다음과 같이 신청하여 주시기 바랍니다.

1 모집개요

- 지원목적 : 「2025 차세대 반도체 패키징 산업전」 공동관 참가 희망 기업
- 지원대상 : 경기도 내 반도체 기업(소재·부품·장비·패키징·팹리스 등)
- 신청자격 : 공고일 현재, 사업자등록증상 경기도에 소재하여야 함
- 선정업체 : 11개 업체(경기도관 0, 파빌리온관 0)
 - ※ 경기도관(소재·부품·장비·패키징 관련 전시), 파빌리온관(팹리스 관련 전시)
 - ※ 경기도관과 파빌리온관 지원비율에 따라 각 관의 총 선정업체 수 선정

※ 제외대상

- 휴·폐업 중인 법인 및 개인사업자 (신청일 기준)
- 기타 제한 사유가 있거나 허위 또는 부정한 방법으로 신청한 기업 및 기관

※ 지원 제외

- 사업 계획서를 허위로 작성하여 선정된 경우
- 선정 이후 사업 진행 중 지원 제외사항 발견 시 선정취소, 제재 조치

- 지원내용 : 산업전 부스 제공

구 분	세부내용	수 량	비 용	비 고
지 원 사 항	< 부스(3m×3m) 2개 제공 > - 구조물(블럭시스템, 바닥마감) - 전기조명(HQI lamp, 콘센트, 전력 등) - 3D 로고(회사 사인) - 실사 그래픽 - 미팅테이블, 바스툴	1식	응 기 원 담	변경불가 (디자인, 수량 등)
비지원 사 항	기타 필요 물품, 홍보물 등	-	참가기업 부 담	

2

선정관련

- 선정기준 : 1차 적격평가 후 2차 평가 진행하여 고득점 순위로 선정
- 평가자 : 차세대융합기술연구원
- 평가기준표

항 목	평가분야	배 점	평가요소	증빙자료											
계		100													
정량평가 (50점)	① 매출액	15	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="3">매 출 액(2024.12.31.기준)</th> </tr> <tr> <th>50억 이상</th> <th>10억 이상 ~ 50억 미만</th> <th>10억 미만</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>배점</td> <td>15</td> <td>13</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	구분	매 출 액(2024.12.31.기준)			50억 이상	10억 이상 ~ 50억 미만	10억 미만	배점	15	13	10	'24년도 재무제표, 부가세과세표준증명원 택1
	구분	매 출 액(2024.12.31.기준)													
		50억 이상	10억 이상 ~ 50억 미만	10억 미만											
	배점	15	13	10											
② 고용인원	15	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="3">직 원 수</th> </tr> <tr> <th>50명 이상</th> <th>20명 이상 ~ 50명 미만</th> <th>20명 미만</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>배점</td> <td>15</td> <td>13</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	구분	직 원 수			50명 이상	20명 이상 ~ 50명 미만	20명 미만	배점	15	13	10	공고일 기준, 4대보험 가입내역 원천징수이행신고서 택1	
구분	직 원 수														
	50명 이상	20명 이상 ~ 50명 미만	20명 미만												
배점	15	13	10												
③ 박람회 참여실적	10	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="3">참여실적</th> </tr> <tr> <th>5회 이상</th> <th>3회 이상 ~ 5회 미만</th> <th>3회 미만</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>배점</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	구분	참여실적			5회 이상	3회 이상 ~ 5회 미만	3회 미만	배점	10	8	6	최근 3년 박람회 참여실적 증명서	
구분	참여실적														
	5회 이상	3회 이상 ~ 5회 미만	3회 미만												
배점	10	8	6												
④ 홍보실적	10	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="2">홍보</th> </tr> <tr> <th>홈페이지 운영</th> <th>카탈로그 제작</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>배점</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	구분	홍보		홈페이지 운영	카탈로그 제작	배점	5	5	홈페이지 주소 및 카탈로그 제출				
구분	홍보														
	홈페이지 운영	카탈로그 제작													
배점	5	5													
정성평가 (50점)	① 산업전 참가계획	20	<ul style="list-style-type: none"> · 박람회 참가 적합성(10) · 박람회 참가 구체적 계획(10) 	참가계획서											
	② 결과활용 가능성	30	<ul style="list-style-type: none"> · 기업 성과창출 가능성(10) · 경기도 기대효과(10) · 차별화된 강점(10) 												

※ 기타사항 : 참가 포기 기업 발생 또는 예산 잔액 발생 시, 예비 순위 기업으로 순차 지원

※ 참가신청한 경기도관, 파빌리온관 각 구분하여 상기배점표로 평가하며, 각 공동관별 구분하여 지원한 업체별 고득점순으로 선정

3

신청 기간 및 방법

- 신청기간 : 2025년 6월 4일(수) ~ 7월 3일(목) 18:00까지
 - ※ 접수 시간은 관련 서류 제출 시간을 기준으로 하며, 마감 시간 이후 접수 불가
- 신청방법 : 차세대융합기술연구원 홈페이지 온라인 신청
 - 연구원 홈페이지 > 행사 참여 > 행사 접수
 - 문의처: cho77@snu.ac.kr / 031-888-9570
 - ※ 홈페이지에 첨부서류 용량초과시 참가신청파일은 홈페이지에 접수하고, 기타서류는 상기이메일로 송신

* 제출서류

- ① 참가신청서 1부 [붙임1 서식]
- ② 2025 차세대 반도체 패키징 산업전 참가계획서 1부 [붙임2 서식]
- ③ 성실 이행서약서 1부 [붙임3 서식]
- ④ 개인·기업 정보 이용 및 제공동의서 1부 [붙임4 서식]
- ⑤ 사업자등록증 사본 1부
- ⑥ 신청자격, 평가기준표 참고하여 증빙자료(매출액, 종업원 수, 박람회 참여 실적, 홈페이지 운영자료, 카탈로그 등) 제출

□ 기타 유의사항

- 제출서류에서 허위사실 적발 시 참여기관의 선정을 취소할 수 있음
- 선정기관에 한하여 추가적인 서류 요청이 있을 수 있음
- 본 안내 내용은 사정에 따라 일부 변경될 수 있음



2025 「차세대 반도체 패키징 산업전」 공동관



참가계획서

1. 회사소개	
업 체 명	
회사소개	
주요기술	
주요실적	

2. 세부계획	
참가목표	
참가인원	※ 부스운영계획
전시제품	※ 전시제품, 모형, 시연 여부 등 구체적 작성
제품 기술성 경쟁력	※ 경쟁제품 대비 품질 및 경쟁력
기대효과	※ 산업전 참가에 따른 유무형의 기대효과 등 기재



2025 「차세대 반도체 패키징 산업전」 공동관

사업 성실 이행 서약서



우리 기업은 「2025 차세대 반도체 패키징 산업전」 공동관에 참여하여 반도체 시장 저변 확대와 공동관 운영의 전반적인 사항에 적극적으로 참여하도록 하겠으며, 제출한 신청서 및 사업계획에 따라 행사 준비에 차질이 없도록 사업추진에 성실히 임하며, 불이행시 책임질 것을 서약합니다.

본인은 위 서약서 내용을 충분히 숙지하였습니다.

2025년 월 일

업체명 : (날인)



2025 「차세대 반도체 패키징 산업전」 공동관

개인 · 기업정보 이용 및 제공 동의서



업 체 명		사업자번호	
대표자명		E-Mail	
전화번호		휴대전화	
<개인정보의 수집·이용·제공에 관한 동의 안내>			
동의를 거부할 수 있으며, 동의를 거부할 경우 지원 제한의 불이익이 있습니다.			
1. 개인정보 수집 및 이용 동의			
수집·이용 목적	2025 차세대 반도체 패키징 산업전 지원을 위한 연락·확인 등		
수 집 하 는 개인정보 항목	회사명, 주소, 사업자등록번호, 전화번호, 팩스번호, 대표자 및 담당자 이름, 이메일, 휴대전화		
보유·이용 기간	영구(단, 5년 이후 정보 주체가 개인정보 삭제를 요청할 경우 파기)		
보유·이용 근거	개인정보 주체자의 이용 동의		
추가 수집 항목	※ 없음		
개인정보의 수집 및 이용목적에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의함 <input type="checkbox"/> 동의하지 않음			
2. 개인정보의 제3자 제공 동의			
제 공 목 적	추진사업의 실적(성과)보고 등에 활용		
제 공 하 는 개인정보 항목	회사명, 주소, 사업자등록번호, 전화번호, 팩스번호, 대표자 및 담당자 이름, 이메일, 휴대전화		
제 공 기 간	영구		
제 공 받 는 기 관	중앙·지방정부 및 산하기관, 사업 수행 및 운영기관		
제 공 근 거	개인정보 주체자의 이용 동의		
제3자 제공 동의에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의함 <input type="checkbox"/> 동의하지 않음			
<p>귀 기관이 상기의 개인·기업정보를 「개인정보 보호법」 제15조 및 제17조에 따라 「2025 차세대 반도체 패키징 산업전」 참가 지원 및 사후관리에 관하여 개인·기업정보를 수집하고 제3자에게 제공·활용하는데 동의합니다.</p> <p style="text-align: center;">2025년 월 일</p> <p style="text-align: right;">업 체 명 : 대 표 자 : (인)</p>			